

# Prensa A Vácuo Quente Automática De 15 Toneladas Com Placas Aquecidas De 200X200Mm E Refrigeração A Água

Número do item: XP33



## introdução

Explore a prensa a vácuo quente automática de 15 toneladas da KINTEK: placas aquecidas de 200x200mm (até 500°C), controle PID preciso, refrigeração a água e câmara em SUS 304 para processamento a vácuo ou gás inerte — perfeita para células de baterias pouch, laminação de polímeros e ligação por difusão.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Laminação de Células Pouch de Bateria	A laminação de células pouch para baterias de íons de lítio ou estado sólido requer pressão e calor uniformes para ligar as camadas sem danificar o eletrólito. A capacidade de vácuo remove a umidade e os gases, evitando a delaminação e melhorando a longevidade da célula.	Elimina a delaminação, melhora a condutividade iônica e estende a vida útil do ciclo.
Laminação de Filme de Polímero	Lamina folhas de polímero ou filmes compósitos para encapsulamento eletrônico, embalagem médica ou telas flexíveis sob temperatura e pressão controladas.	Produz ligações sem bolhas e de alta clareza com controle preciso de espessura.
Ligação por Difusão	Une metais, ligas ou cerâmicas em temperaturas elevadas sob alto vácuo sem fusão, criando ligações de difusão atômica.	Alcança interfaces de alta resistência e sem poros, ideais para trocadores de calor e dispositivos microfluídicos.
Compactação e Sinterização de Pós	Comprime pós de metal ou cerâmica em uma matriz sob vácuo e calor para formar peletes ou pré-formas densas.	Aumenta a densidade, reduz a porosidade e melhora as propriedades mecânicas e elétricas.
Cura de Materiais Compósitos	Cura compósitos avançados reforçados com fibras com perfis de pressão e temperatura precisos em atmosfera inerte.	Otimiza a reticulação, previne a oxidação e garante laminados sem vazios.
Montagem de Eletrônica Flexível	Lamina e encapsula circuitos flexíveis, telas OLED ou sensores de filme fino com adesivos ativados por calor sob vácuo.	Mantém o alinhamento, elimina defeitos de desgaseificação e protege componentes sensíveis.

Especificação	Valor / Detalhes
Modelo	XP33
Pressão Máxima de Trabalho	≤ 15 Toneladas (150 kN)
Temperatura de Trabalho da Placa	Temperatura Ambiente - 500 °C, tela de toque PID programável
Potência de Aquecimento	3000 W
Dimensões da Placa	200 mm × 200 mm
Abertura da Placa (Vão)	50 mm
Bomba de Vácuo Incluída	Bomba de Vácuo de Palhetas Rotativas (padrão)
Nível de Vácuo (Relativo)	< -0,1 MPa
Material da Câmara	Aço Inoxidável SUS 304
Compatibilidade com Gás Atmosférico	Nitrogênio (N <sub>2</sub> ) / Argônio (Ar)
Método de Resfriamento	Refrigeração a Água Circulante (ambas as placas)

Especificação	Valor / Detalhes
Dimensões Externas	650 x 492 x 725 mm
Peso Líquido	235 kg
Alimentação	AC 220V / 50Hz, Monofásico